

トーカロ株式会社 個人投資家向け企業IRセミナー



(東証プライム 3433)

2025年3月13日

TOCALO トーカロ株式会社



本日の内容

1. 事業概要
2. 中期経営計画の進捗状況
3. 特長と強み
4. 持続的成長に向けた取り組み
5. 株主還元

1. 事業概要

トーカロ株式会社

事業内容: **溶射を中心とした表面改質加工**

本 社 : 兵庫県神戸市

設 立 : 1951年7月

資 本 金 : 26億5,882万3千円

売 上 高 : 連結 467億35百万円(2024年3月期)

従業員数: 連結 1,389名(2024年3月末現在)



代表取締役 社長執行役員
小林 和也

当社の主な事業所



本社・神戸工場・明石工場・播磨工場
溶射技術開発研究所

倉敷工場



北九州工場



名古屋工場



宮城技術
サービスセンター

東京工場
(鈴身事業所・行田事業所)



グループ会社



日本コーティング センター株式会社

設立年月:1985年4月
本社:神奈川県
出資比率:100%
主な事業分野:PVD処理加工

TOCALO USA, Inc.

設立年月:2015年11月
本社:米国 CA州
出資比率:100%
主な事業分野:溶射(半導体他)



東賀隆(昆山)電子 有限公司

設立年月:2011年5月
本社:中国 江蘇省
出資比率:90%
主な事業分野:溶射(半導体・FPD)



株式会社寺田工作 所

設立年月:1986年8月
本社:福岡県
出資比率:100%
主な事業分野:機械加工

漢泰国際電子股份 有限公司

設立年月:2011年6月
本社:台湾 台南市
出資比率:50%
主な事業分野:溶射(半導体・FPD)



東華隆(広州)表面改質 技術有限公司

設立年月:2005年4月
本社:中国 広東省
出資比率:70%
主な事業分野:溶射(鉄鋼他)



PT. TOCALO Surface Technology Indonesia

(非連結子会社で持分法非適用)

設立年月:2017年6月
本社:インドネシア
出資比率:100%
主な事業分野:溶射(鉄鋼他)

TOCALO Surface Technology (Thailand) CO., Ltd.

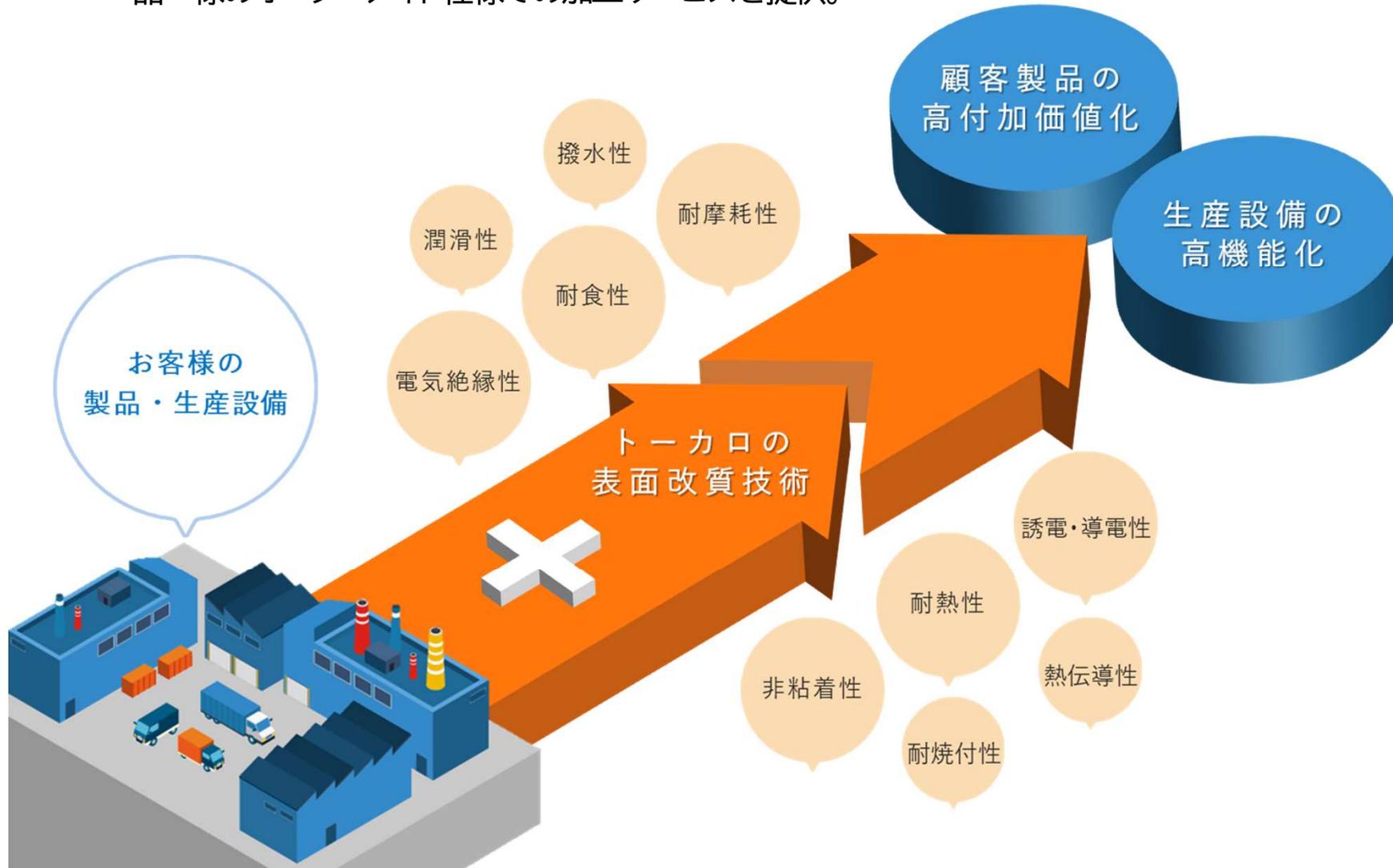
(非連結子会社で持分法非適用)

設立年月:2012年10月
本社:タイ
出資比率:100%
主な事業分野:溶射(鉄鋼他)

当社の表面改質技術

POINT

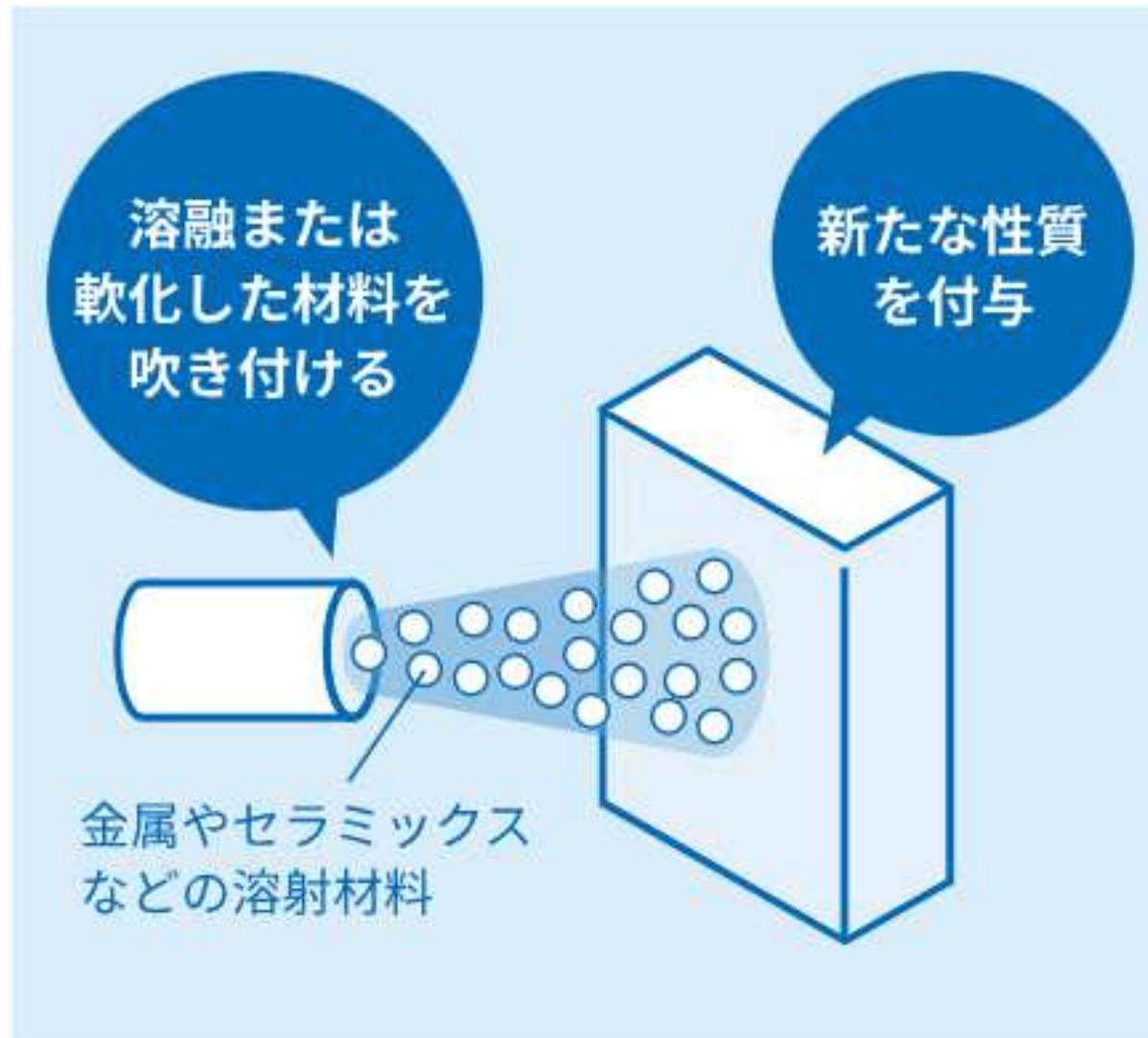
当社は厚膜から薄膜までの多種多様な表面改質技術を保有しており、顧客の様々な製品・生産設備に対して一品一様のオーダーメイド仕様での加工サービスを提供。



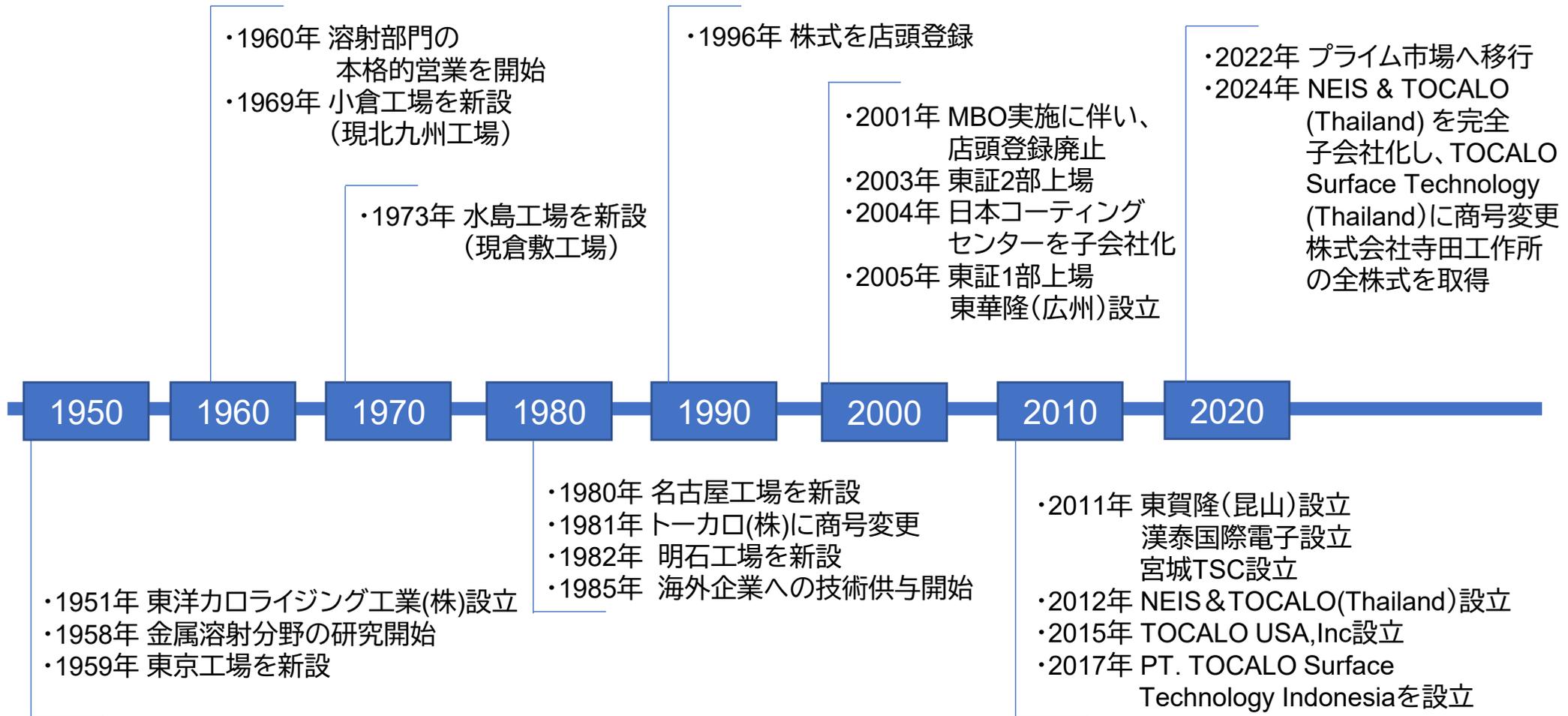
溶射とは



溶射とは、溶射材料を溶かして吹き付け、皮膜を形成するコーティング方法。



トーカロのあゆみ



鉄鋼分野の成長

半導体分野
への参入

半導体・海外市場
の拡大

業績の推移 (1951年度～)

POINT

創業以来赤字はなし、リーマンショックなど厳しい経済環境の中でも安定的に成長

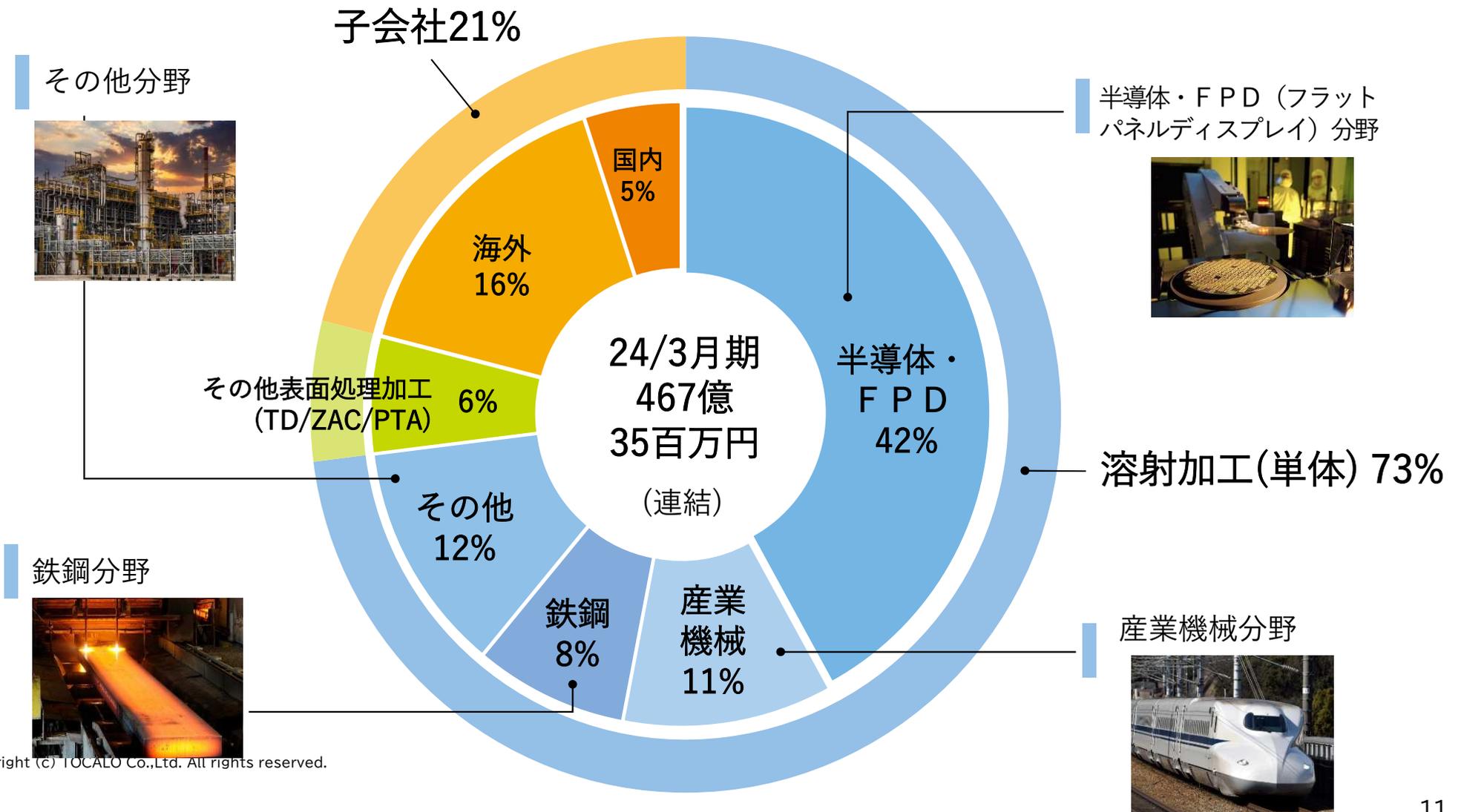
■ トーカロ売上 (半導体・FPD以外)
 ■ トーカロ売上 (半導体・FPD)
 ■ 連結子会社売上
 ● 経常利益 (連結)



さまざまな産業界に広がる事業領域

POINT

半導体・FPD製造装置関連が約42%をしめていますが、その他にも、産業機械分野や鉄鋼分野などの幅広い業界で、事業を展開しています。

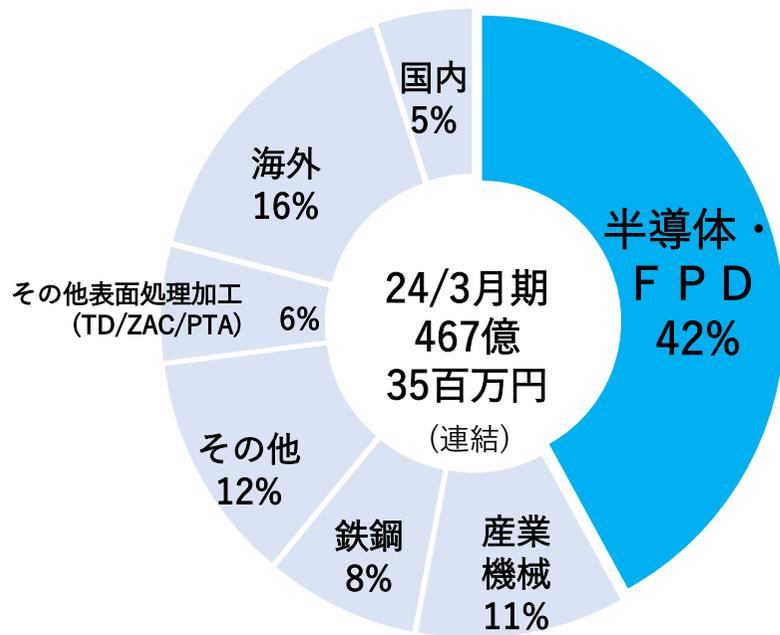


事業内容① (半導体・FPD分野)

主な取扱い事例

半導体製造装置

- ① プラズマエッチング処理装置のゴミ発生防止と耐久性アップを目的とした表面処理
- ② 半導体ウエハや液晶ガラス基板を真空中で固定するための静電チャック



【主要なお取引先様】 東京エレクトロン株式会社

POINT 半導体分野の在庫調整が一巡し受注が復調
第3四半期累計の受注実績は19,364百万円 (前年同期比26.8%増)



トーカロ × 半導体製造装置

■ 半導体・FPD製造装置部品

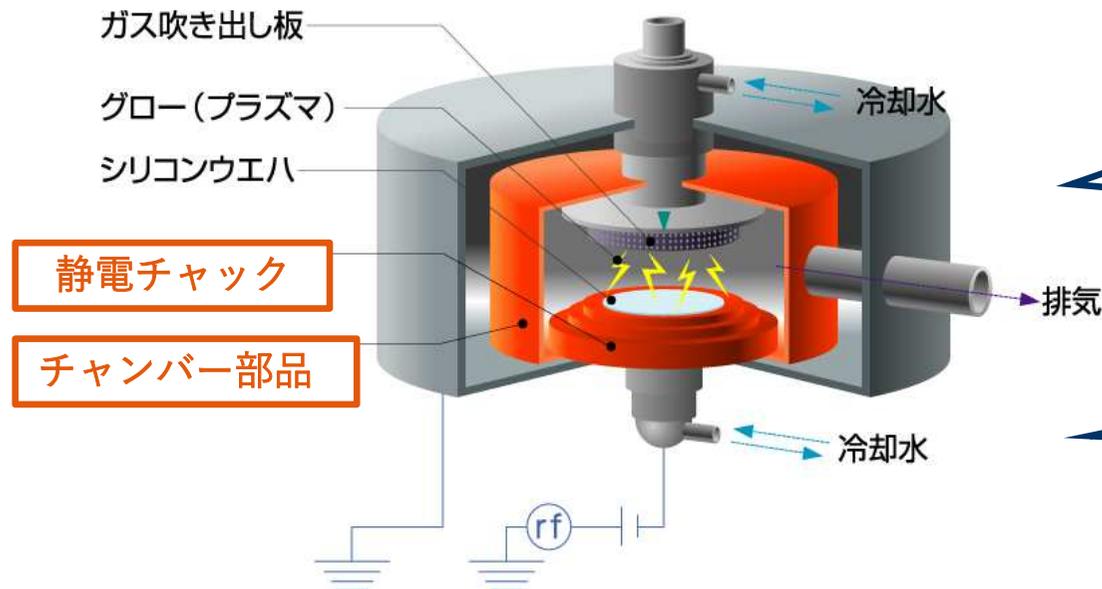
半導体製造工程 (前工程)



※ エッチング工程とは？

焼き付けられたレジスト以外の部分を削り取る工程

ドライエッチング装置



付加する機能①

シリコンウェハを静電気で吸着 (固定) させる。

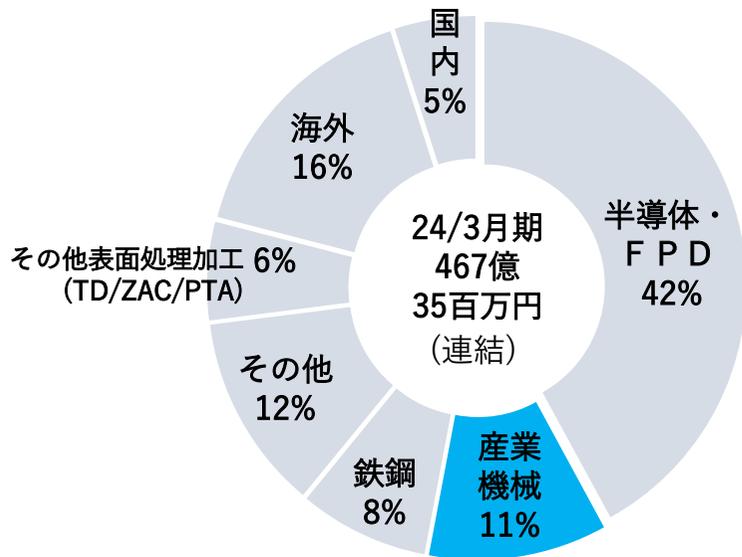
付加する機能②

耐プラズマ性 (発塵防止)

事業内容② (産業機械分野)

主な取扱い事例

- ガスタービン部材
- NAS電池
- 電気絶縁ベアリング
- 発電用ボイラーパネル
- 電極材製造装置部品など

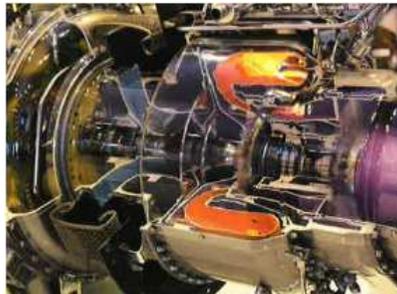


ガスタービン



付加する機能

耐熱性

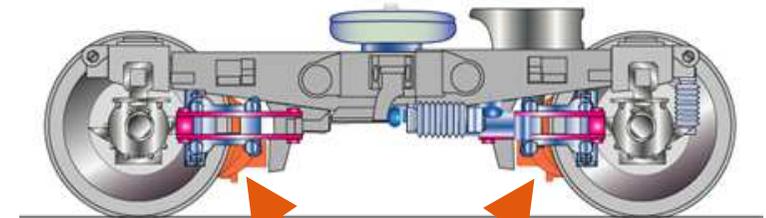


電機絶縁ベアリング



付加する機能

電気絶縁性 (電食防止)

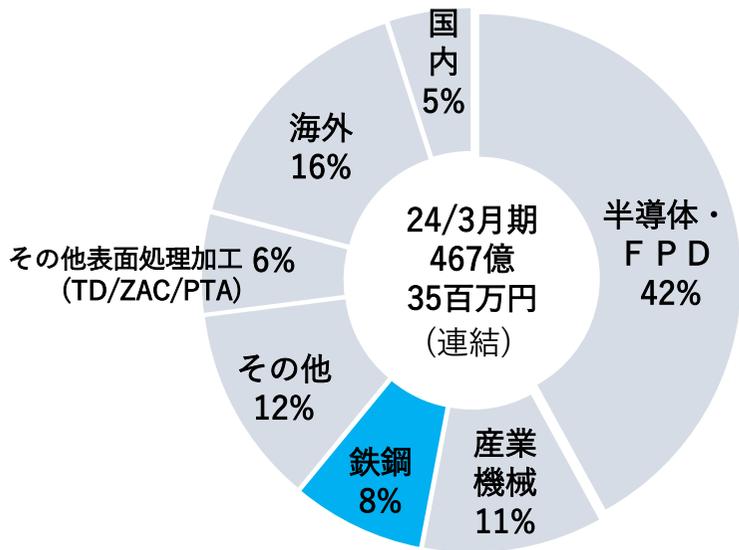


駆動モーター

事業内容③ (鉄鋼分野)

主な取扱い 事例

- 炉内ロール、亜鉛浴中ロール など
- 耐ビルドアップ(堆積物) ○耐熱 ○耐摩耗 ○耐食



ハースロール(炉内ロール)



付加する機能

耐熱、耐ビルドアップ、耐食、耐摩耗など



シンクロール(浴中ロール)

事業内容④ (その他の分野)

主な取扱い事例

- 石油精製・化学プラント関連
- 風力・水力発電設備部品
- 製紙ロール
- ガラス搬送ロール
- 航空機エンジン部材 など

製紙(ヤンキードライヤーロール)

耐熱、耐食、耐摩耗など



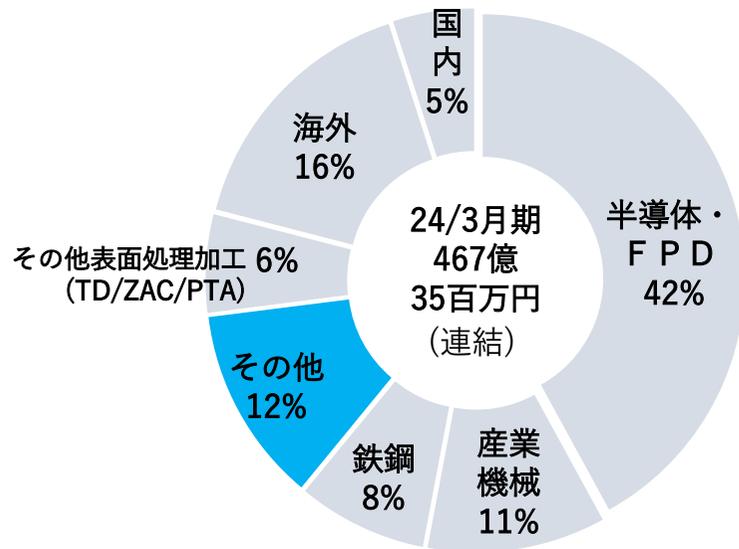
航空機部品



石油精製



水力発電



事業内容⑤ (その他表面処理)

主な取扱い 事例

- TD処理
- ZAC処理
- 農機
- 医療
- 半導体製造装置部品など

■ TD処理

農業機械部品



耐摩耗性



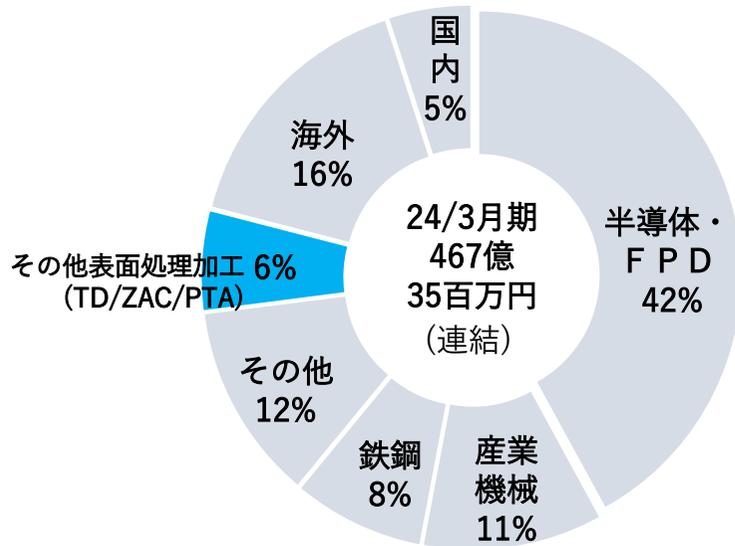
■ ZAC処理

医療関連

生体への
親和性向上



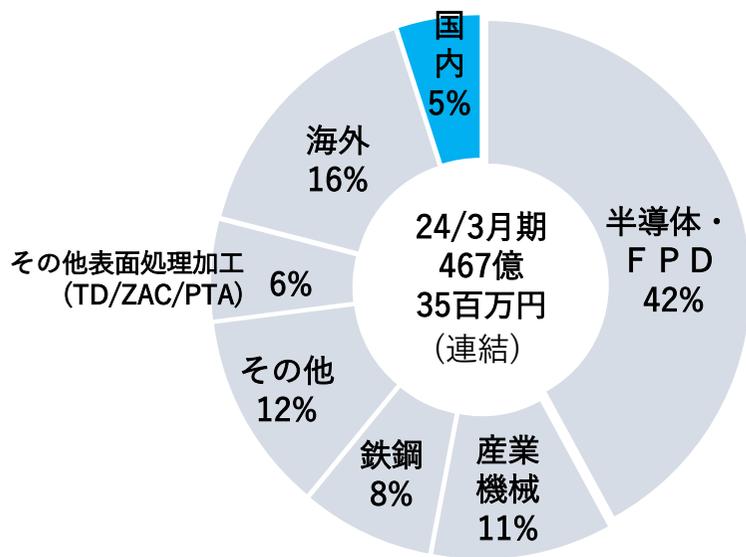
半導体製造装置部品



国内子会社

主な取扱い事例

自動車関連向け切削工具へのPVD処理加工など



■日本コーティングセンター株式会社

本社:神奈川県
出資比率:100%



自動車関連向け切削工具

■株式会社寺田工作所

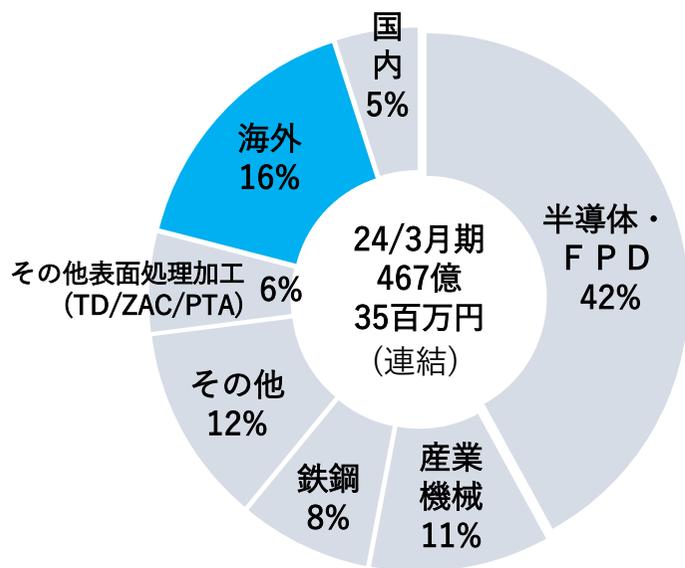
本社:福岡県
出資比率:100%
各種機械加工



海外子会社

主な取扱い事例

- 鉄鋼関連：東華隆(広州)表面改質技術有限公司
- 半導体関連：東賀隆(昆山)電子有限公司、TOCALO,USA,Inc.、漢泰国際電子股份有限公司



東華隆(広州)表面改質技術有限公司

設立年月: 2005年4月
本社: 中国 広東省
出資比率: 70%
主な事業分野: 溶射(鉄鋼他)



TOCALO USA, Inc.

設立年月: 2015年11月
本社: 米国 CA州
出資比率: 100%
主な事業分野: 溶射(半導体他)



東賀隆(昆山)電子有限公司

設立年月: 2011年5月
本社: 中国 江蘇省
出資比率: 90%
主な事業分野: 溶射(半導体・FPD)



漢泰国際電子股份有限公司

設立年月: 2011年6月
本社: 台湾 台南市
出資比率: 50%
主な事業分野: 溶射(半導体・FPD)



売上高と経常利益の見通し

POINT

半導体分野の回復により、
過去最高の売上高となる見込み

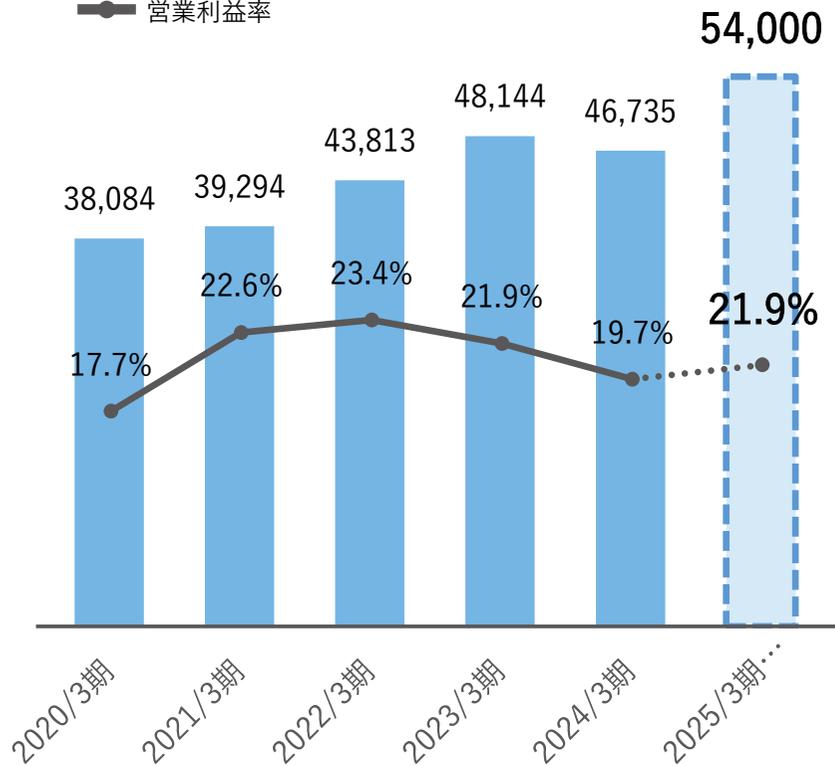
POINT

経常利益も2期前を上回り、
過去最高となる見込み

売上高

前期比
+9.1%

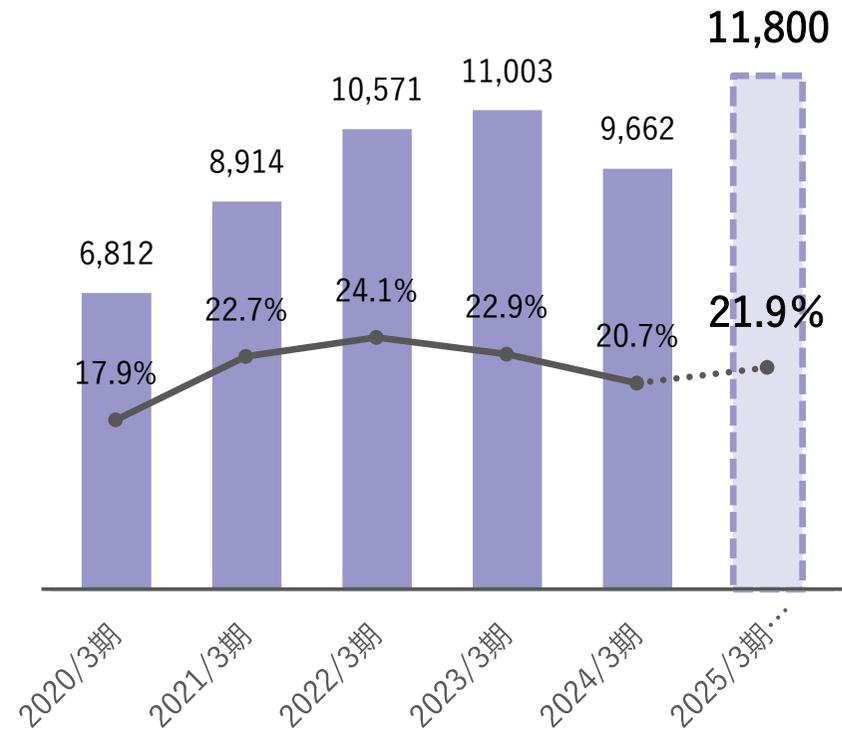
売上高(百万)
営業利益率



経常利益

前期比
+8.7%

経常利益(百万円)
経常利益率



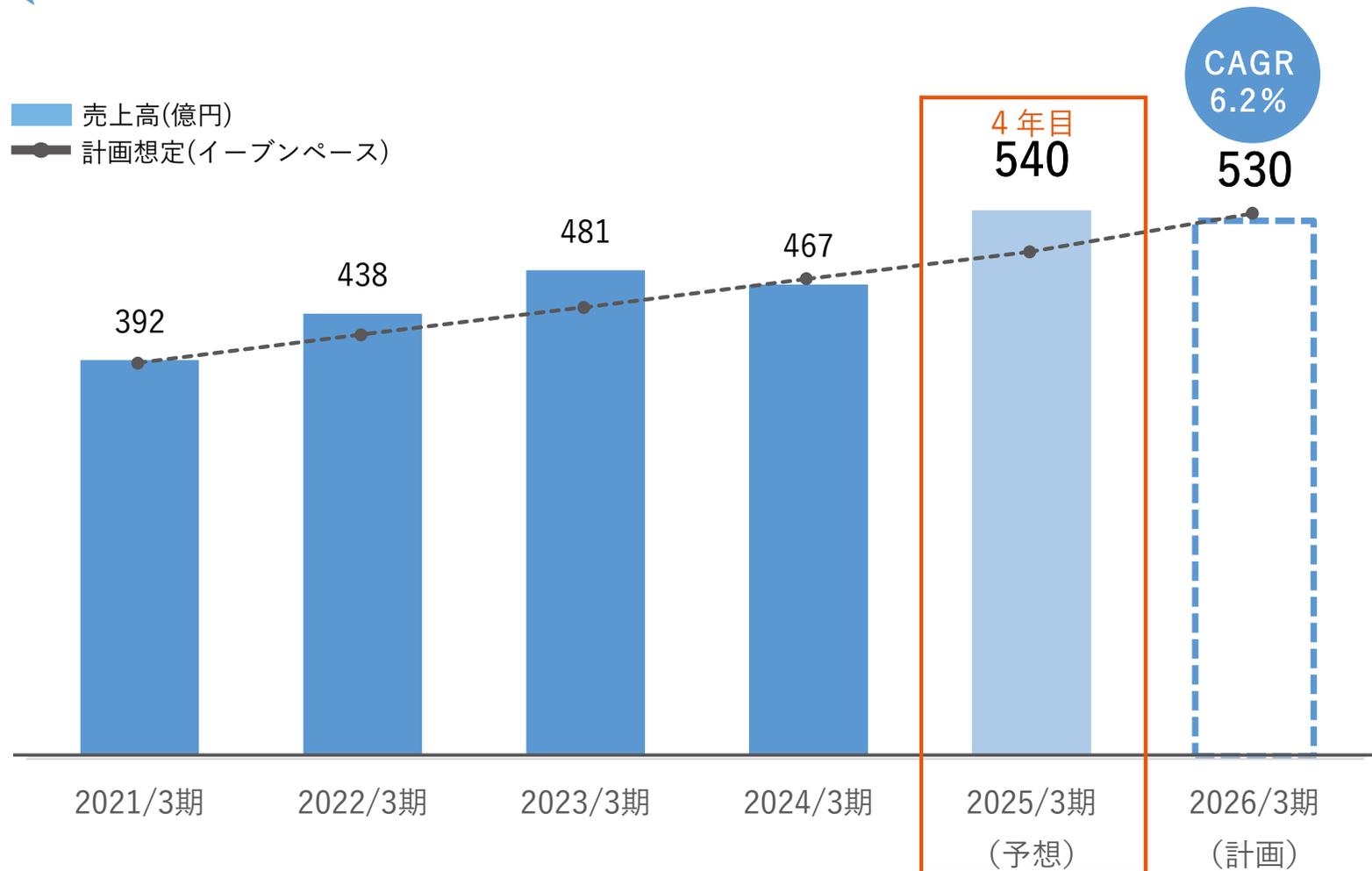


3.中期経営計画の進捗状況

中期経営計画（売上高）の進捗状況

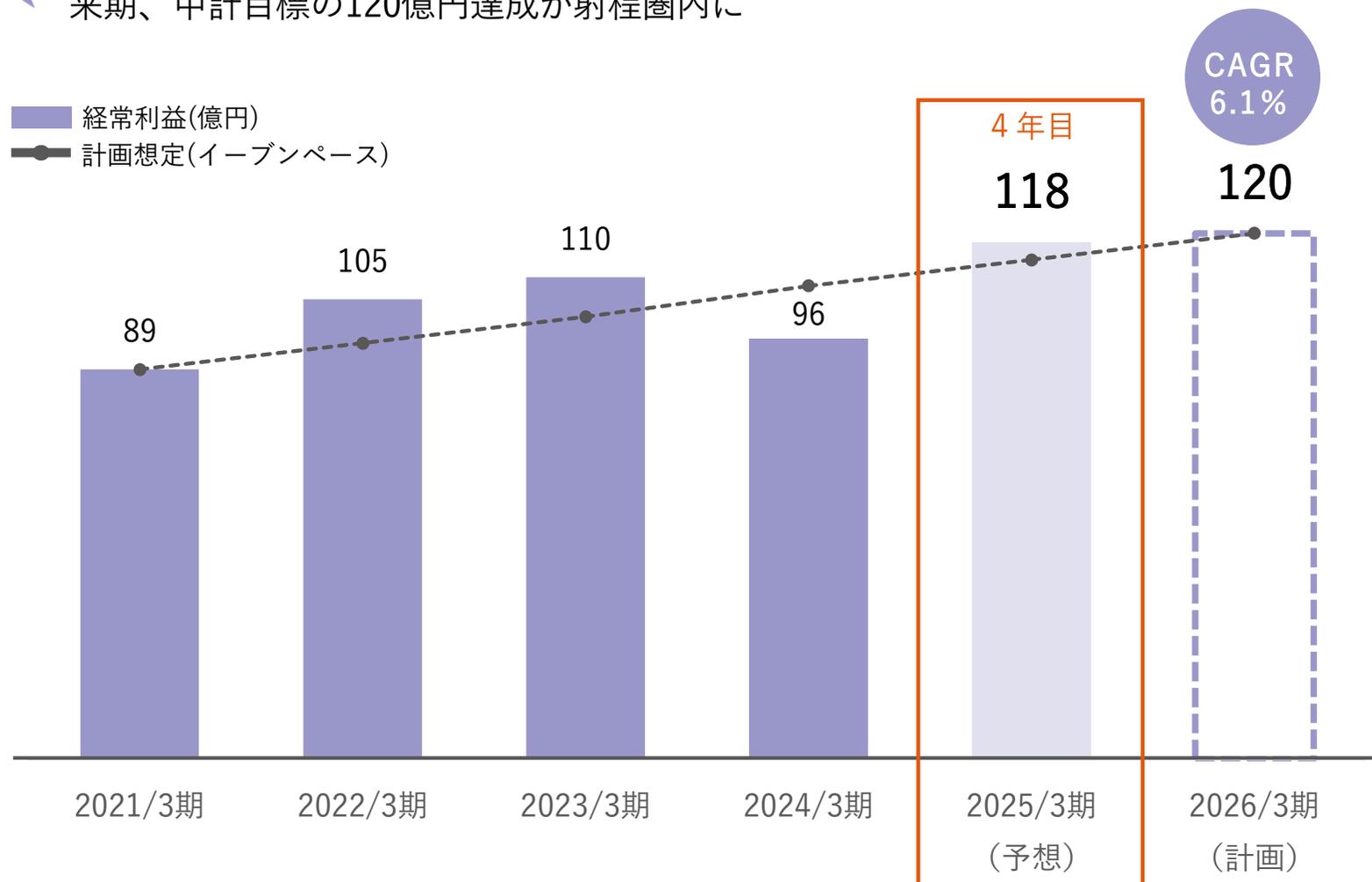


2025年3月期の売上高は、中計目標530億円を1年前倒しで達成すると予想



中期経営計画（経常利益）の進捗状況

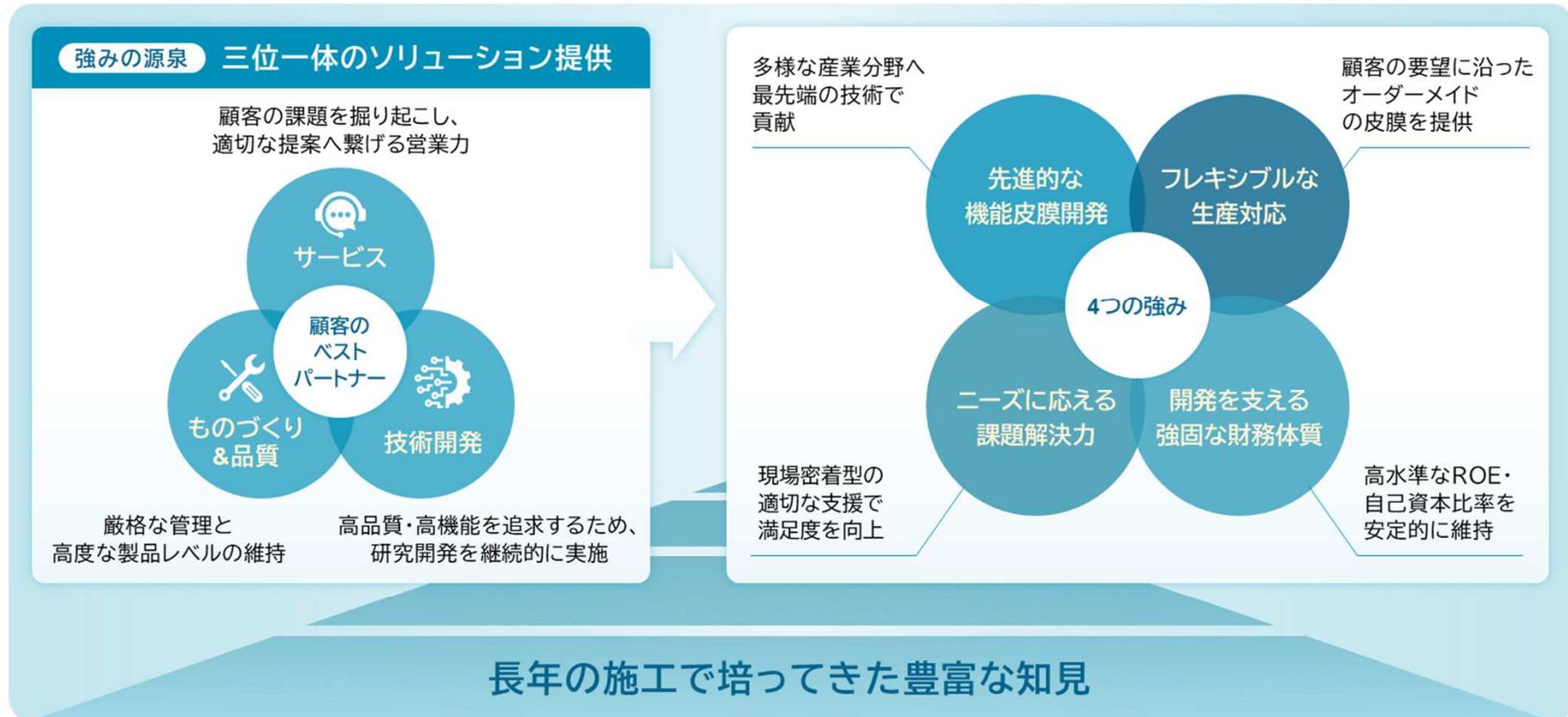
★ POINT 2025年3月期の経常利益予想は、計画どおりの水準まで回復
来期、中計目標の120億円達成が射程圏内に



4. 特長と強み

競争優位性

あらゆる製造業の様々なニーズへの対応を通じて培った「表面改質技術に対する豊富な知見」が源泉となり、高い競争優位性を生み出している。



技術交流や共同開発でより一層の企業価値向上へ

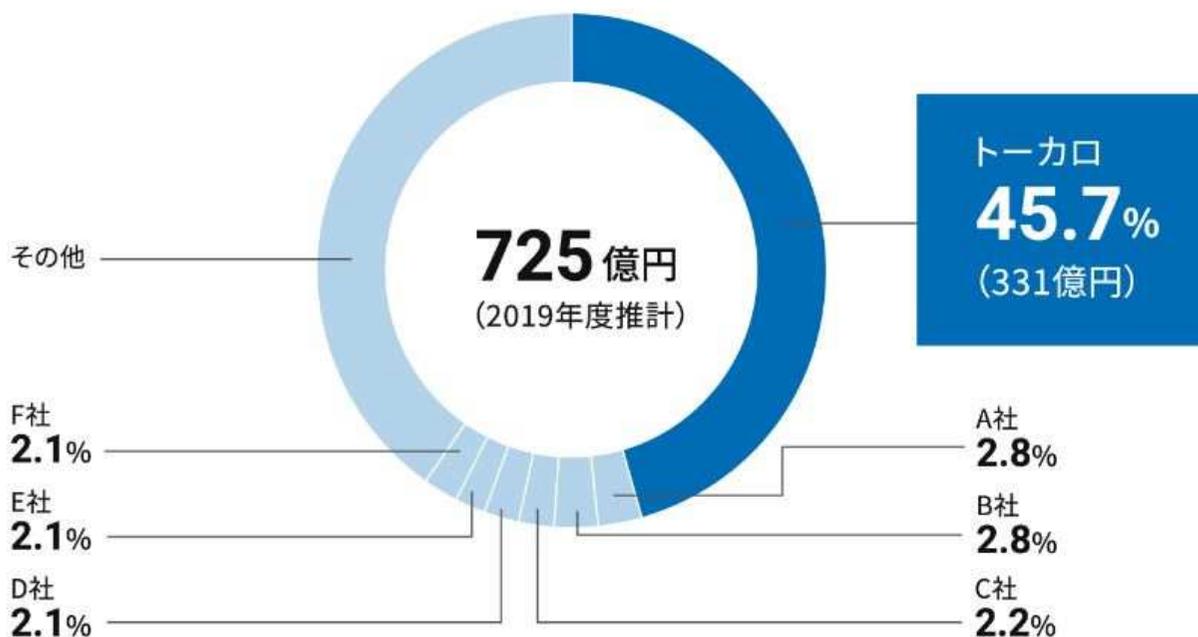
ニッチトップ



受託加工サービスの国内溶射市場は**約700億円**。

トーカロは**4割強のシェア**を占めています。

国内溶射市場（ジョブショップ市場）

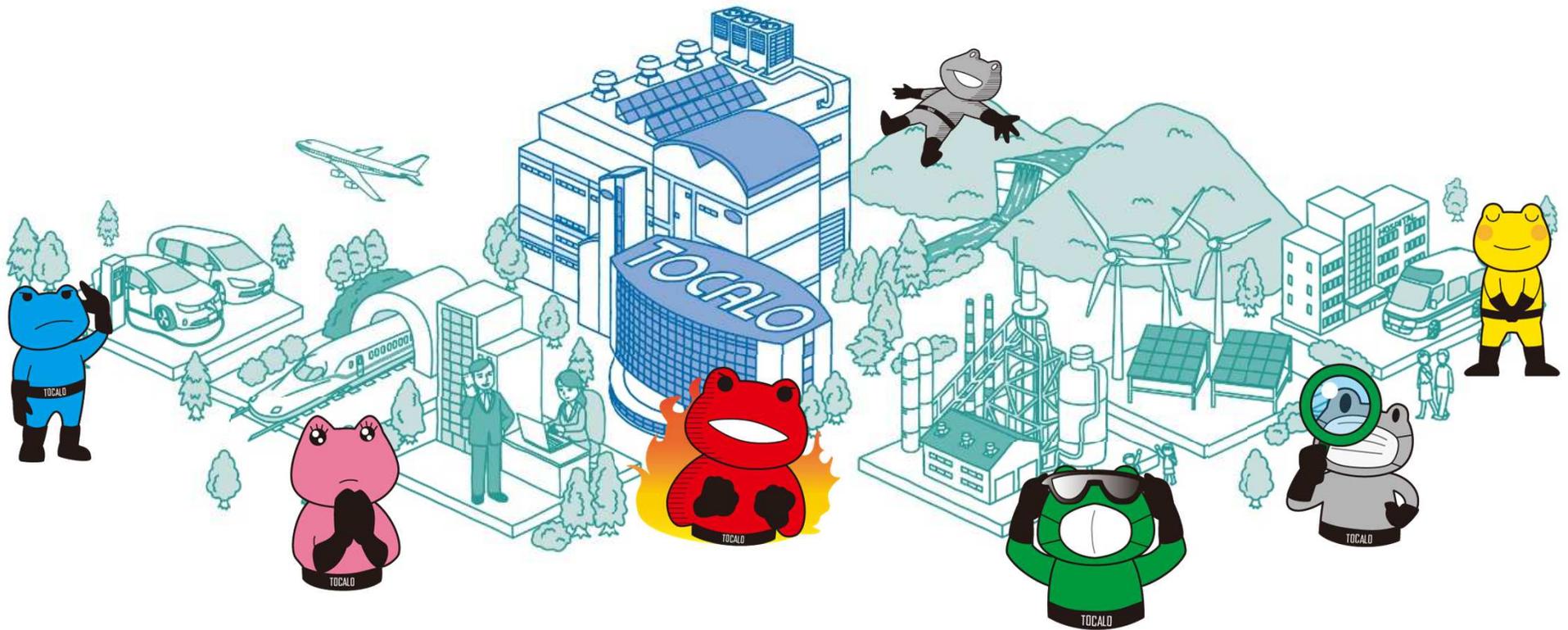


出所「溶射業界における市場調査及び将来市場展望報告書」
 発行所：株式会社矢野経済研究所 監修：日本溶射工業会、一般社団法人日本溶射学会

現場密着



セールスエンジニア**約100名**が、お客様の製造現場に密着し、
当社技術で解決できる課題を見つけて提案します。

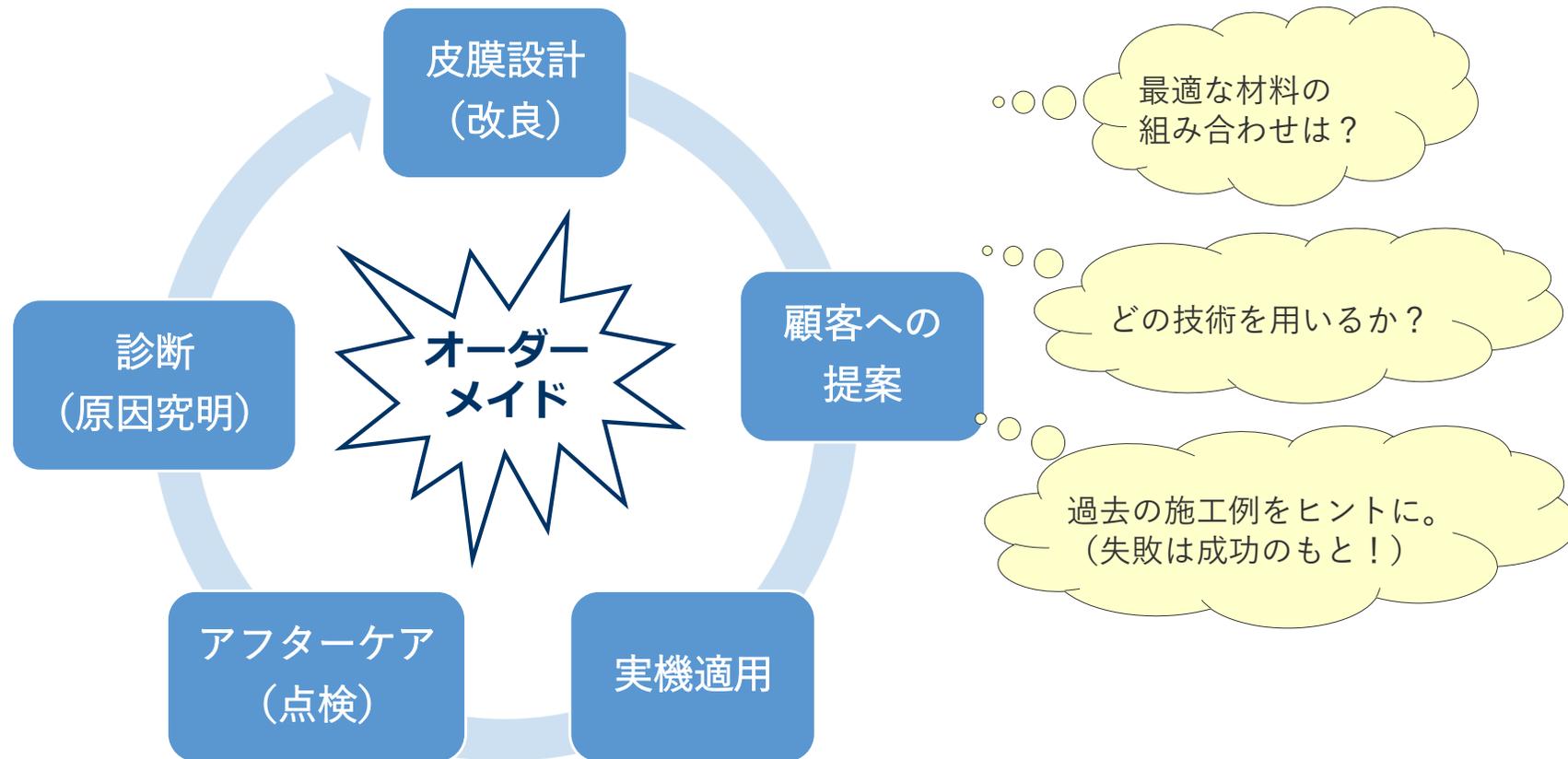


お客様が気付いていない**潜在的なニーズ**さえも！

オーダーメイド



1000種類以上のコーティング材料、多様な表面改質技術、
そして豊富な施工実績に基づくオーダーメイド仕様。



研究開発



お客様の様々なニーズに応えるため、至るところで研究開発。
先進的な機能性皮膜を常に追い求めています。



研究開発費は
 連結売上高比
 で3%を維持



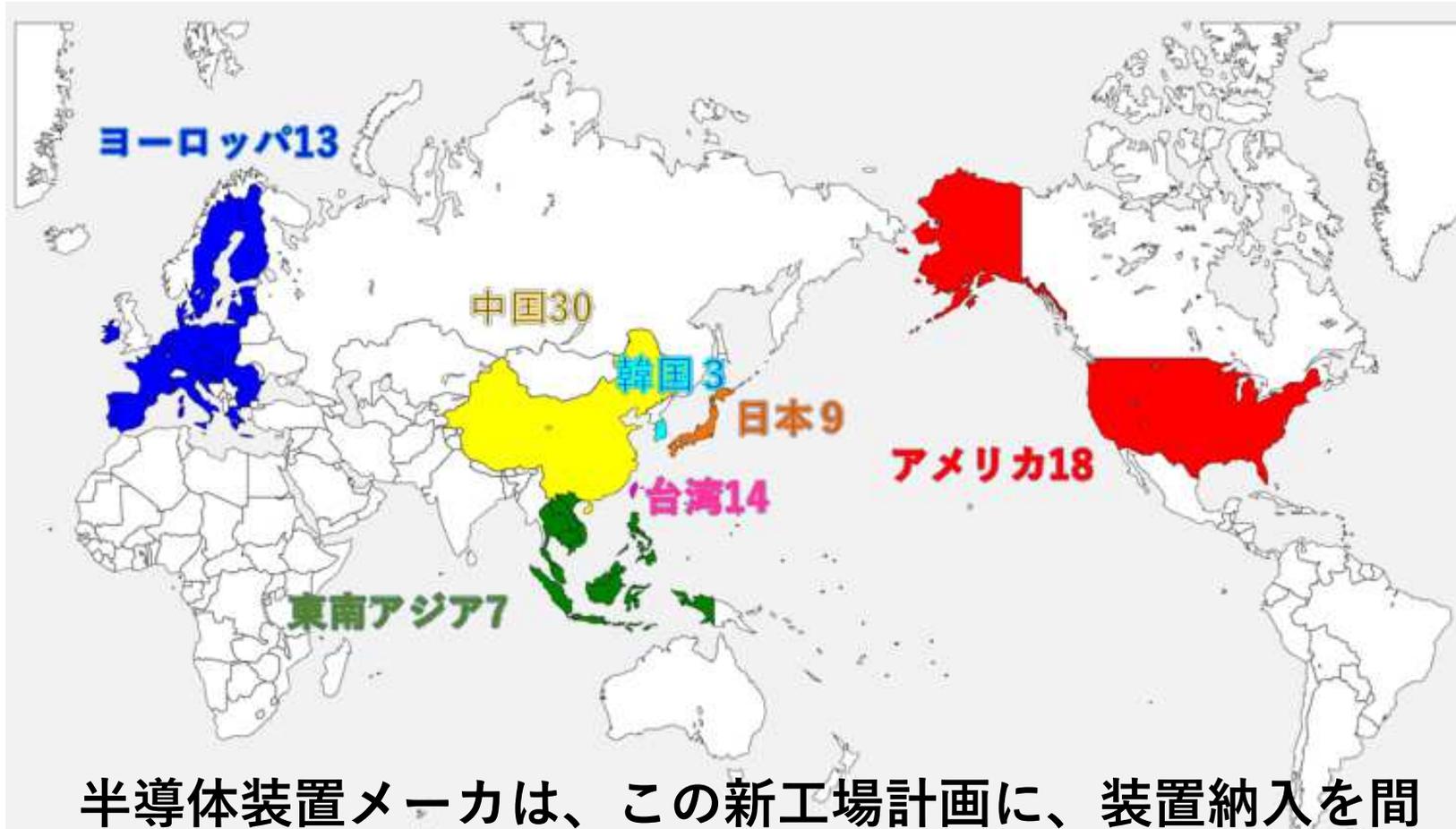
No.1 & Only 1 技術・サービスの
 創出で世界をリードします。



4. 持続的成長に向けた取り組み

世界半導体の新工場

半導体生産工場は2022年までに世界64工場あり、
2023年には14工場が新しく稼働開始、更に80工場を建設計画へ。



半導体装置メーカーは、この新工場計画に、装置納入を間に合わせるため、2030年に向けて更なる増産を計画。

出所：SEMI World Fab Forecast 3Q23 (Sept. 2023)を基に当社作成

2030年に向けた売上成長イメージ

外部環境

- 半導体市場は、2030年に向けて約2倍に拡大する
- 顧客（製造業）のニーズとして、環境負荷低減や省エネなどへの対応の重要性が高まる

成長戦略

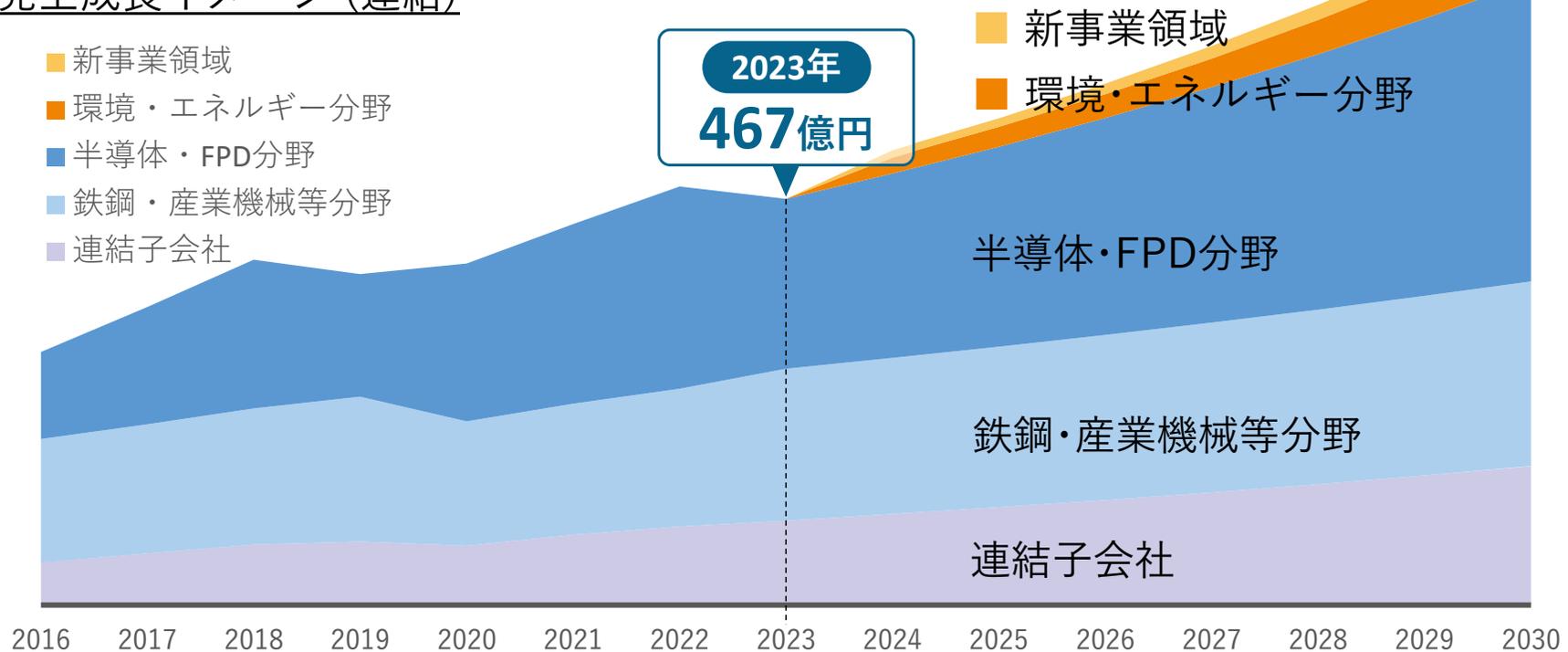
- 生産能力増強と自動化・省人化のための積極的な設備投資
- 半導体の微細化・多層化への対応をはじめ、新事業領域の開拓に向けた次世代皮膜開発

※検討中のイメージ

2030年
800億円～

売上成長イメージ（連結）

- 新事業領域
- 環境・エネルギー分野
- 半導体・FPD分野
- 鉄鋼・産業機械等分野
- 連結子会社



2025/3期～2027/3期の主な設備投資(予測)

今後も市場の伸びが予測される半導体・FPD分野の拡大を主眼に置き、①新工場の建設、②先端設備の導入、③研究設備の導入の3本立ての設備投資を実行する

① 新工場の建設

神戸工場の新工場棟
(兵庫県神戸市)

13億円

半導体・医療分野などで、その他表面処理の適用拡大と生産効率化を図る
2024年5月着工、2025年3月竣工予定

鈴身事業所の新工場棟
(千葉県船橋市)

56億円

半導体製造装置メーカーからの受注増加を見据え、増産体制を整える
2025年7月着工、2026年10月竣工予定、設備導入や顧客認証を経て2027年夏頃稼働

北九州工場の新工場棟
(福岡県京都郡)

32億円

半導体製造装置メーカーからの受注増加を見据え、増産体制を整える
2025年7月着工、2026年10月竣工予定、設備導入や顧客認証を経て2027年夏頃稼働

② 先端設備の導入

自動化・省人化や高機能化
を企図した先端設備

12億円

自動化・省人化等を実現する先端設備の導入により、生産性向上と品質管理の強化を図る

③ 研究設備の導入

次世代技術開発のための
研究装置、測定・評価設備

10億円

半導体の微細化・多層化への対応をはじめ、新事業領域の開拓に向けた次世代皮膜開発のための研究設備等を導入する

グローバル展開のトピックス

【トーカー】 海外事業本部を新設

2024年4月に、グローバル展開を加速するため海外事業本部を新設しました。海外子会社・ビジネスパートナーとの連携強化、海外市場の開拓に一層注力します。

【中国】 東賀隆（昆山）電子有限公司で新工場を立ち上げ

中国政府が進める半導体国産化を背景として、半導体関連の受注増加が見込まれることから、新工場を急ピッチで立ち上げています。

【台湾】 漢泰国際電子股份有限公司で新工場完成

台湾半導体メーカーTSMC社（世界最大手）の動向に合わせ、溶射リコートビジネスの生産能力拡大を企図し建設していた新工場が完成しました。

【タイ】 NEIS & TOCALO (Thailand) CO., Ltd.を完全子会社化、新工場建設

溶接事業のナイス株式会社（尼崎市）が51%、当社が49%を出資して2012年10月に設立したNEIS & TOCALO (Thailand) CO., Ltd.の全株式を取得しました。経営資源を溶射事業に集中するとともに新工場を建設し、業容の拡大を図ります。

5. 株主還元

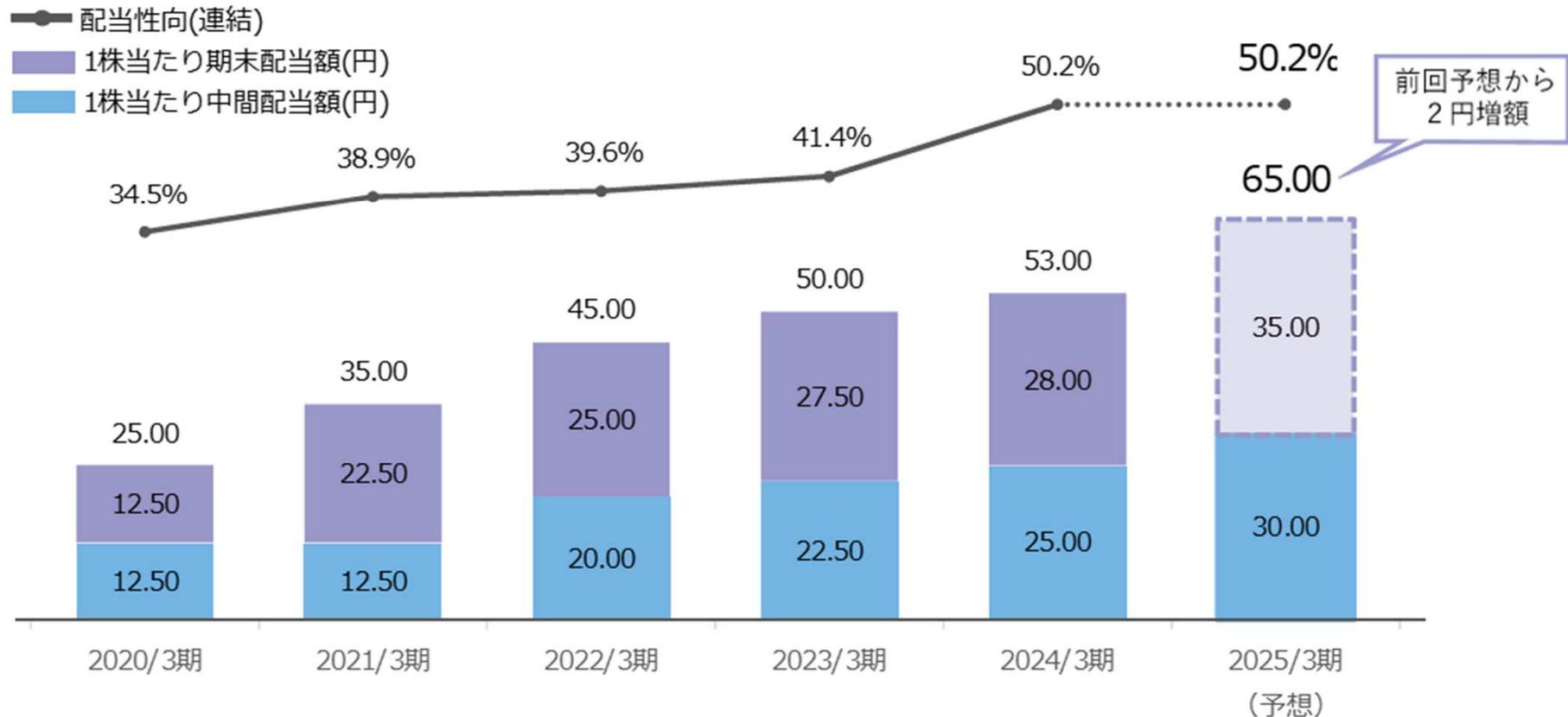
1株当たり配当額と配当性向の推移

POINT

2025年3月期の年間配当は、前回予想から2円増額の65円 (配当性向50.2%) を予定

株主還元方針

- 連結配当性向50%程度および純資産配当率 (DOE) 5%以上を目標とする
- 自己株式の取得も、事業環境や財務状況などを考慮しつつ機動的に実施



個人投資家向け企業IRセミナーの振り返り



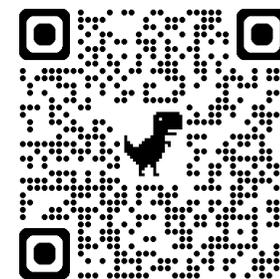
今日はこれだけは覚えていただければ幸いです

- トーカロはニッチトップ、国内溶射市場で**4割強のシェア**を占めています。
- 半導体市場の回復により、今期は**過去最高の売上高**となる見込み
- 今後の**半導体市場の拡大**による需要にこたえるために、国内外ともに積極的な設備投資**(64億円以上予定)**を実施
- 連結配当性向 **50%程度**および純資産配当率 (DOE) 5%以上を目標、2025年3月期の年間配当は **65円**を予定

The background is white and features several orange plus signs and four-pointed stars of varying sizes and opacities scattered across the upper half of the page. The plus signs and stars are in shades of orange and yellow, creating a warm and celebratory atmosphere.

ありがとうございました。

Q&A



当社コーポレートサイト